

MBE 装置を用いた $\text{Fe}_{65}\text{Ni}_{35}$ インバー薄膜の組成制御実験

北海道大学工学研究科 ○田中 岳 柴田 隆行 高橋 義美 牧野 英司 池田 正幸

要旨

高温Kセルを採用した MBE 装置を用いて Fe、Ni の成膜実験を行い、得られた成膜速度から FeNi 合金薄膜の組成制御条件を検討した。その結果、Fe1380°C、Ni1350°Cの成膜温度で Fe 組成 66.2at%の FeNi 合金薄膜を形成した。また表面性状は、蒸着ムラの少ない緻密で平滑な面で、X 線回折の結果 fcc、bcc が混在する薄膜特有の構造であった。

1.はじめに

マイクロマシンのアクチュエータとして発生力、変形量が大きいので薄膜バイメタルが使用されている。 $\text{Fe}_{65}\text{Ni}_{35}$ インバー合金はバイメタルの低膨張合金として用いられるが、薄膜化によって変形量の増大、熱応答性の向上が期待できる。本研究では MBE 装置の高温クヌーセンセル（以下、Kセル）を用いて FeNi 合金薄膜を形成し、インバー薄膜としての組成制御の可能性を検討した。

2. 実験装置および方法

図 1 に実験装置の概略を示す。Fe、Ni は Kセルのアルミナルツボで溶融して基板に成膜する。Kセルは、高い指向性で微少粒子を基板へ飛ばすので、安定した成膜速度制御が可能である。最初に Kセル側のシャッタを開き、真空度が一定になったところで基板側のシャッタを開き、成膜を行った。膜厚は触針式表面粗さ計により測定した。組成分析はエネルギー分散 X 線分光法 (EDX) を使用し、薄膜の中央付近 $0.4 \times 0.4\text{mm}$ の範囲で行った。また、微分干渉顕微鏡による表面性状の観察、X 線回折による結晶構造解析を行った。

3. 実験結果および考察

3.1 Fe、Ni の成膜速度

インバー薄膜組成制御に必要な Fe、Ni の成膜速度を求めるために、Fe、Ni 単体での成膜実験を行った。表 1 に Fe および Ni の成膜条件を示す。各成膜温度における成膜時間と膜厚の関係から得られた、Fe、Ni の成膜温度一成膜速度の関係を図 2 に示す。Fe、Ni ともに各成膜温度における成膜速度のバラツキは、最大 10 % であった。実験結果より Fe、Ni の成膜速度 V_{Fe} 、 V_{Ni} を成膜温度 T の関係は、
 $V_{\text{Fe}} = 2.0 \times 10^{-4}T^2 - 0.383T + 218.15$ (1)
 $V_{\text{Ni}} = 7.0 \times 10^{-5}T^2 - 0.1658T + 94.643$ (2)

となる。

3.2 FeNi 合金薄膜の組成制御

Fe 65at%組成の FeNi 合金は、室温での熱膨張係数が 1.2×10^{-6} ($1/\text{K}$) と非常に小さな値を示す¹⁾。本実験では膜厚 200nm、Ni 成膜温度 1350°C一定とし、Fe の成膜速度を変えて、Fe 65at%の合金薄膜の組成制御実験を行った。

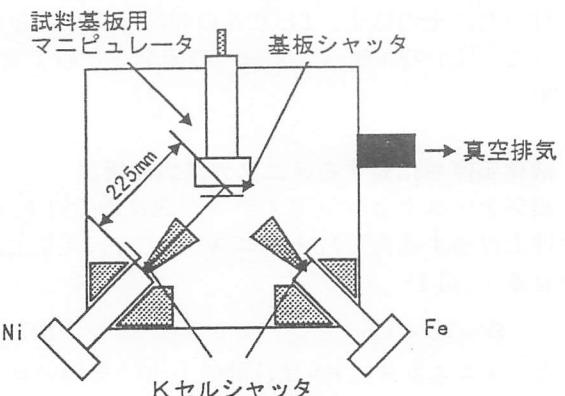


図1 実験装置概略

表1 Fe、Ni 成膜条件

試料	Fe(純度: 99.5%) Ni(純度: 99.99%)
成膜温度(°C)	1150～1425
成膜時間(min)	10～60
成膜時真空度(Torr)	3.0×10^{-7}
基板	7059 ガラス
基板温度	室温

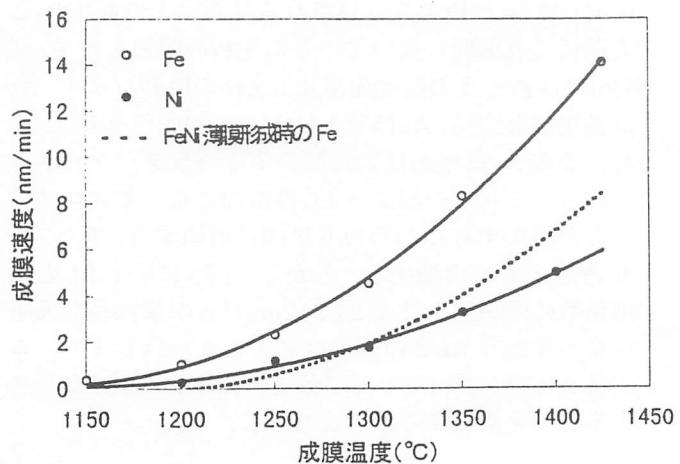


図2 Fe、Ni の成膜温度一成膜速度の関係

成膜速度と原子体積比 $Fe : Ni = 7.10 : 6.5$ ($\text{cm}^3 / \text{g} \cdot \text{atom}$) となる温度条件、 $Ni 1350^\circ\text{C}$ を一定として $Fe 1325^\circ\text{C}, 1342^\circ\text{C}$ の条件で成膜したが、予想した組成比からそれぞれ 18.5 at%、15.5 at%少なかった。これは、成膜時に Fe 分子が Ni 分子との衝突により散乱されて、基板に到着せず、蒸着されない割合が高いためと考えられる。Fe 組成 60, 65, 70 at%を目標に Fe の温度を改めて設定し、成膜実験を行った。その結果、Fe 成膜温度 1380°C のとき、Fe66.2 at% でインバー組成に最も近い薄膜が形成された。図3に Fe の成膜温度と Fe の組成の関係を示す。図中の●は成膜速度より計算した組成比、○は実験値である。実際の Fe 組成は、成膜速度の比よりも一定の割合で少なくなる傾向を示した。しかし、実際の組成はそれぞれ 66.2, 69.5, 70.8 at%であり設定した値とは異なっていた。図2に示すように、FeNi 薄膜形成時の成膜速度は、Fe 単体の成膜時より遅くなる傾向を示した。FeNi 合金薄膜の形成実験では、Fe 単体の成膜速度よりも

$$\Delta T = 0.1287T - 93.81 \quad (3)$$

低い温度で成膜した速度と同程度であった。組成制御の精度を上げるには、このような補正を考慮する必要がある。

3.3 FeNi 薄膜の表面性状

図4に微分干渉顕微鏡を用いて観察した FeNi 薄膜の表面性状を示す。全体的に平滑で、非常に細かい凹凸が確認された。指向性のある高温Kセルを用いて、組成と膜厚の均一な薄膜を形成できる。

3.4 FeNi 薄膜の結晶構造

図5に FeNi 薄膜のX線回折結果を示す。インバーのバルク材は fcc であるが、薄膜では fcc, bcc が混在することが知られている²⁾。しかし、結晶構造と熱膨張係数の関係は明らかでない。本実験においても Fe66.2 at%の結晶構造は fcc と bcc が混在していた。また Fe 組成が多くなるにつれて、fcc から bcc へ構造が変化する傾向が認められた。また本実験では、膜厚を 200nm 一定に設定して成膜したが、膜厚測定値は Fe 組成が多くなるにつれて、薄くなる傾向にあり、Fe70.6 at%の薄膜で 142.21nm と最も小さな値となった。これは fcc から bcc へ構造が変化すると、格子間隔も 0.3545nm から 0.28681nm へと約 19%縮小するためと考えられる。200nm の膜では 161nm に縮小することになり、実験値に近い。

4.まとめ

- (1) 成膜速度の制御により、 $Fe 1380^\circ\text{C}, Ni 1350^\circ\text{C}$ の成膜温度で Fe66.2 at%の FeNi 薄膜を成膜した。また、FeNi 薄膜形成時の Fe 成膜速度は、単体での成膜速度より遅くなり、組成制御には温度補正が必要である。
- (2) MB E 装置の高温Kセルを用いた成膜により、蒸着ムラの少ない平滑な薄膜が得られた。
- (3) Fe66.2 at%の FeNi 薄膜には fcc, bcc 構造が混在

しており、薄膜バイメタルへの応用のためには、結晶構造と熱膨張係数の関係を検討する必要がある。

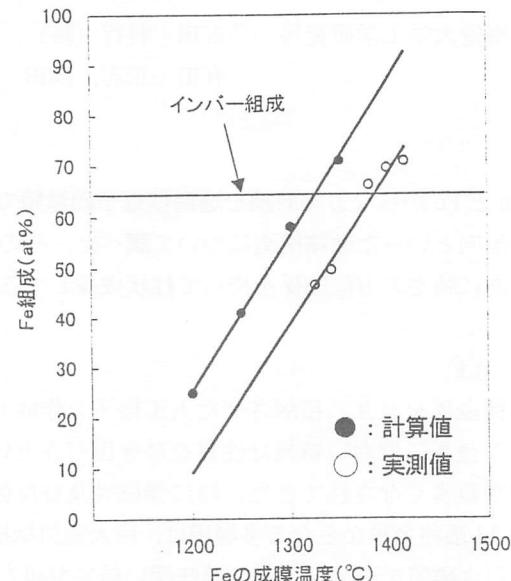


図3 Fe の成膜温度—Fe 組成の関係

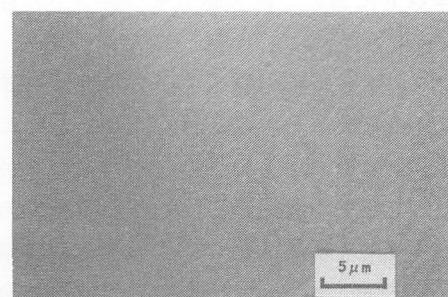


図4 FeNi 薄膜の表面性状

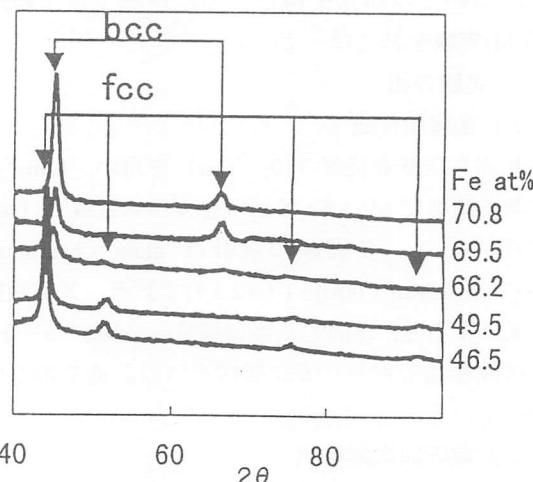


図5 FeNi 薄膜の X 線回折結果

参考文献

- 1) 近角、溝口: 固体物理 3(1968)67
- 2) G.Dumpich, E.Becher, K.Schelz, W.Stamm ほか: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 74 (1988)237-247